

2027年3月期 第1四半期  
**決算説明資料**

2026年8月7日  
**内外テック株式会社**  
(証券コード 3374)



2027年3月期 第1四半期  
**決算ハイライト**

# 本日のポイント

## POINT

# 1

2027年3月期 第1四半期実績  
AI関連を中心とした旺盛な需要を背景に、受注が増加し大幅な増収増益

売上高 **11,536**百万円  
(前年同期比59.9%増)

営業利益 **590**百万円  
(前年同期比7.1倍)

親会社株主に帰属する四半期純利益 **363**百万円  
(前年同期比7.7倍)

## POINT

# 2

2027年3月期予想（上方修正）  
足元の市況及び受注状況を鑑みて上方修正  
増産対応に加え成長戦略に基づく先行投資が増加するも、増収により大幅な増収増益を見込む

売上高 **50,900**百万円  
(前期比56.1%増)

営業利益 **2,560**百万円  
(前期比82.5%増)

親会社株主に帰属する当期純利益 **1,680**百万円  
(前期比72.9%増)

## POINT

# 3

OMT社の子会社化によるフィールド・ソリューション事業の強化  
当社は株式会社OMTの株式を取得し、同社を連結子会社化  
当社グループの中長期的な成長戦略の一環として実行した戦略的M&Aであり、フィールド・ソリューション事業における体制の強化およびグループ収益基盤の安定化を目的



2027年3月期 第1四半期  
**連結業績・事業概況**

# 2027年3月期 第1四半期 業績 (2026年4月～2026年6月)

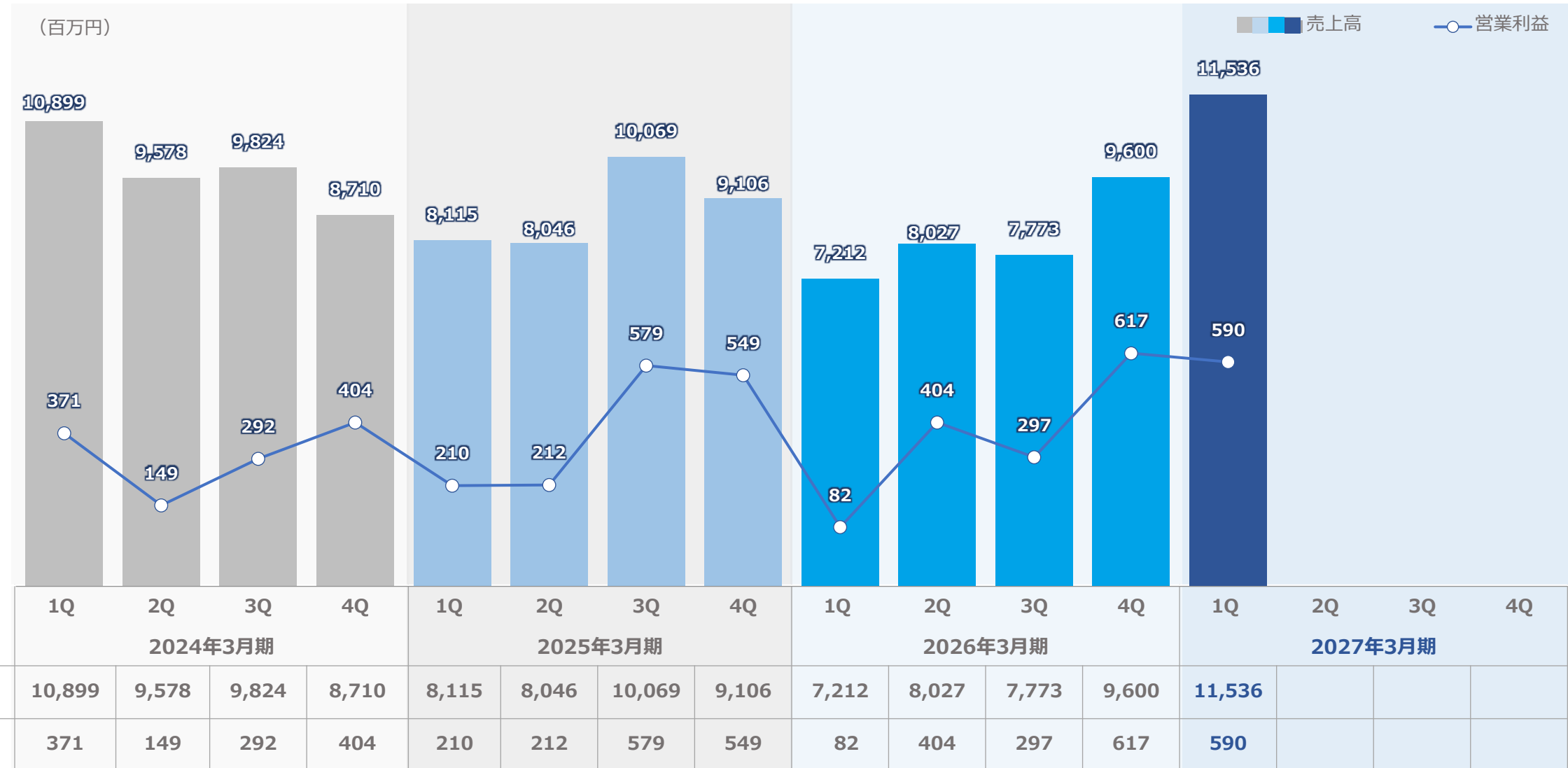
- ・顧客の在庫調整の解消とAIを中心とした主要顧客からの受注が拡大し、売上・利益ともに前年同期比で大幅な増収増益
- ・受注拡大が想定を上回り、各段階利益は第2四半期累計利益予想（26年5月15日公表）を超過

## 決算実績

| (百万円)                | 2026年3月期 1Q |       |        | 2027年3月期 1Q |       |        |                 |
|----------------------|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-----------------|
|                      | 実績          | 構成比   | 前年同期比  | 実績          | 構成比   | 前年同期比  | 進捗率<br>(期初中間予想) |
| 売上高                  | 7,212       | 100.0 | 11.1%減 | 11,536      | 100.0 | 59.9%増 | 60.7%           |
| 売上原価                 | 6,382       | 88.5  | 11.0%減 | 10,078      | 87.4  | 57.9%増 | —               |
| 販管費                  | 747         | 10.4  | 1.9%増  | 866         | 7.5   | 15.9%増 | —               |
| 営業利益                 | 82          | 1.1   | 60.6%減 | 590         | 5.1   | 7.1倍   | 107.0%          |
| 経常利益                 | 83          | 1.2   | 58.8%減 | 597         | 5.2   | 7.1倍   | 112.7%          |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期純利益 | 46          | 0.7   | 46.8%減 | 363         | 3.1   | 7.7倍   | 104.7%          |

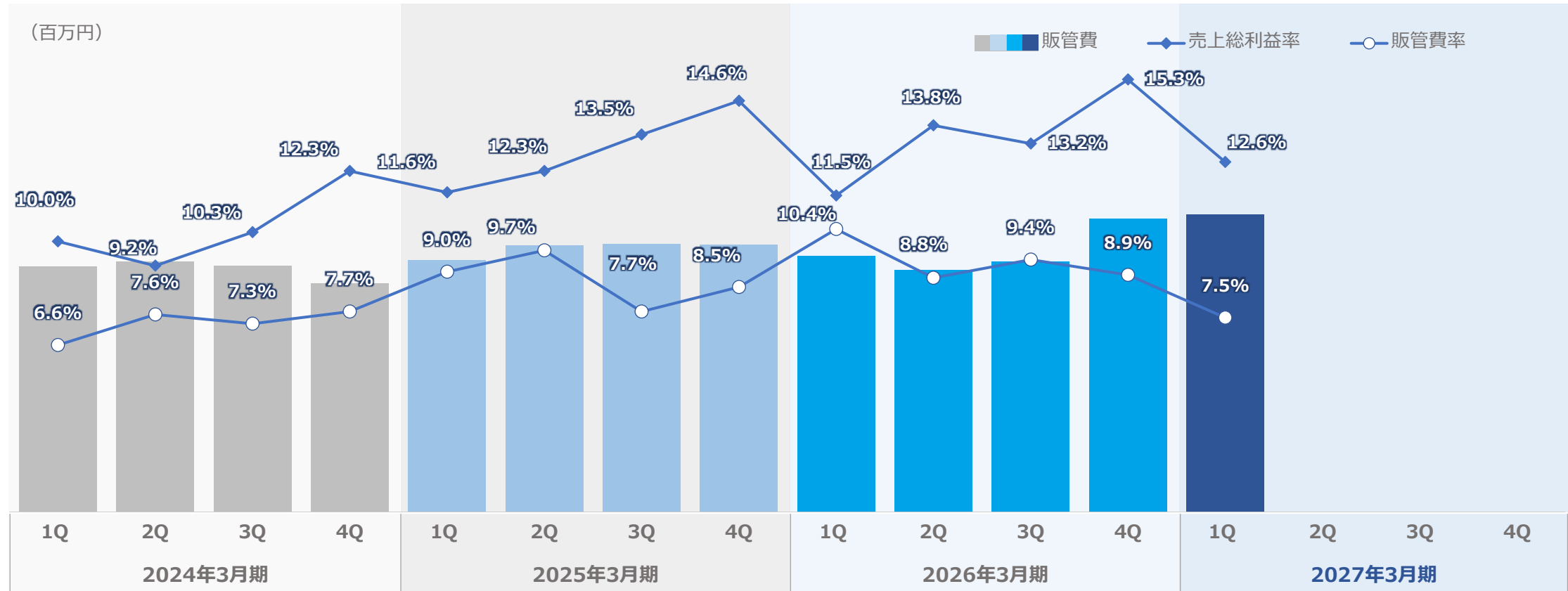
## 売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

- ・売上高は半導体市場の活況を背景とした受注拡大により、引き続き上昇
- ・前4Qに計上された販売報奨金から前4Qと比べ減益になるも、前1Q比で大幅に増益



# 売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

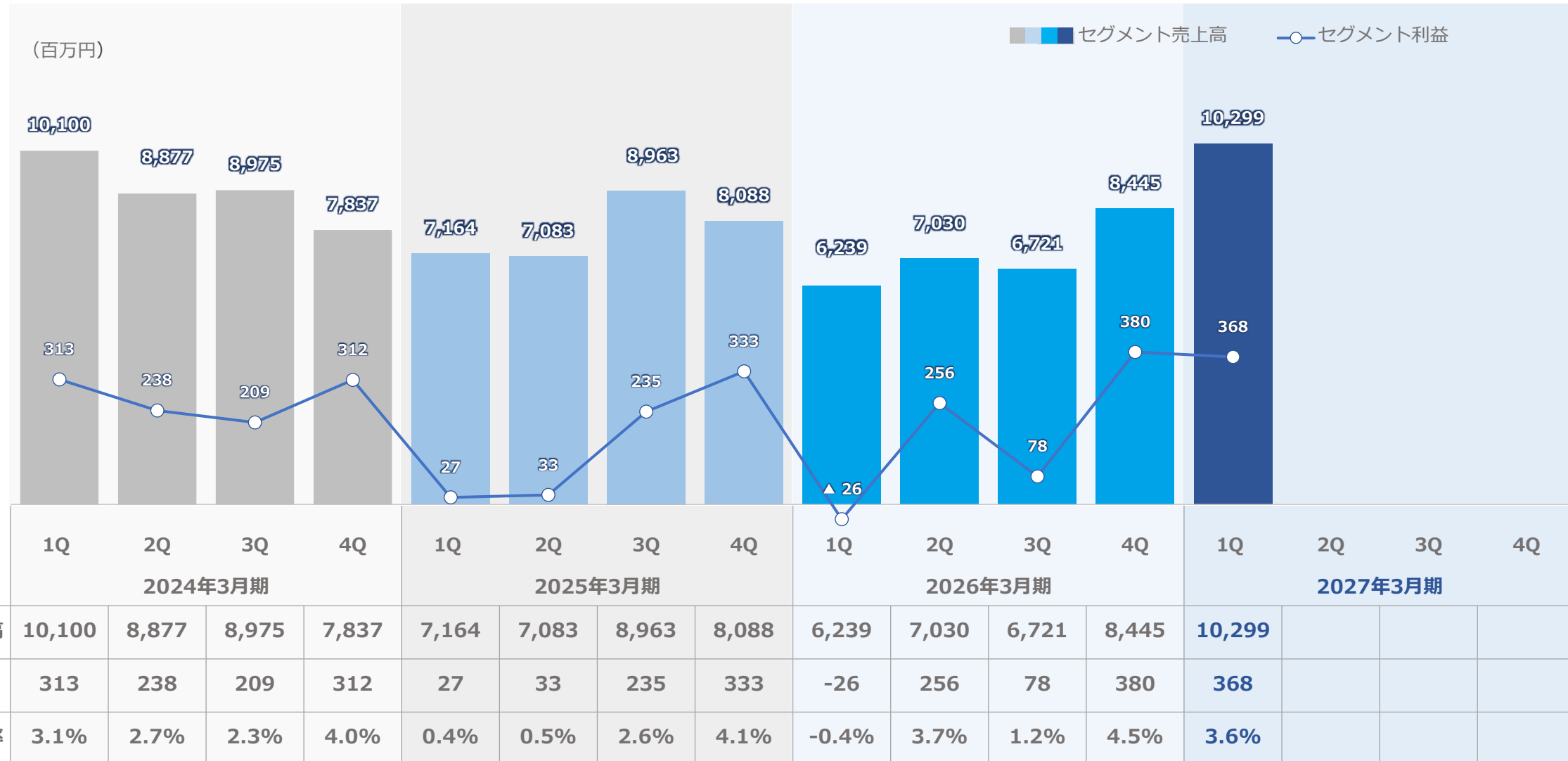
- ・売上総利益率は、4Qの特別要因（販売報奨金）を除き、一定の水準で推移
- ・販管費比率は、売上増加により改善



| (百万円)  | 2024年3月期 |      |       |       | 2025年3月期 |       |       |       | 2026年3月期 |       |       |       | 2027年3月期 |  |  |  |
|--------|----------|------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|--|--|--|
| 売上総利益率 | 10.0%    | 9.2% | 10.3% | 12.3% | 11.6%    | 12.3% | 13.5% | 14.6% | 11.5%    | 13.8% | 13.2% | 15.3% | 12.6%    |  |  |  |
| 販管費    | 716      | 730  | 717   | 666   | 733      | 777   | 780   | 778   | 747      | 706   | 729   | 855   | 866      |  |  |  |
| 販管費率   | 6.6%     | 7.6% | 7.3%  | 7.7%  | 9.0%     | 9.7%  | 7.7%  | 8.5%  | 10.4%    | 8.8%  | 9.4%  | 8.9%  | 7.5%     |  |  |  |

# セグメント別概況 販売事業

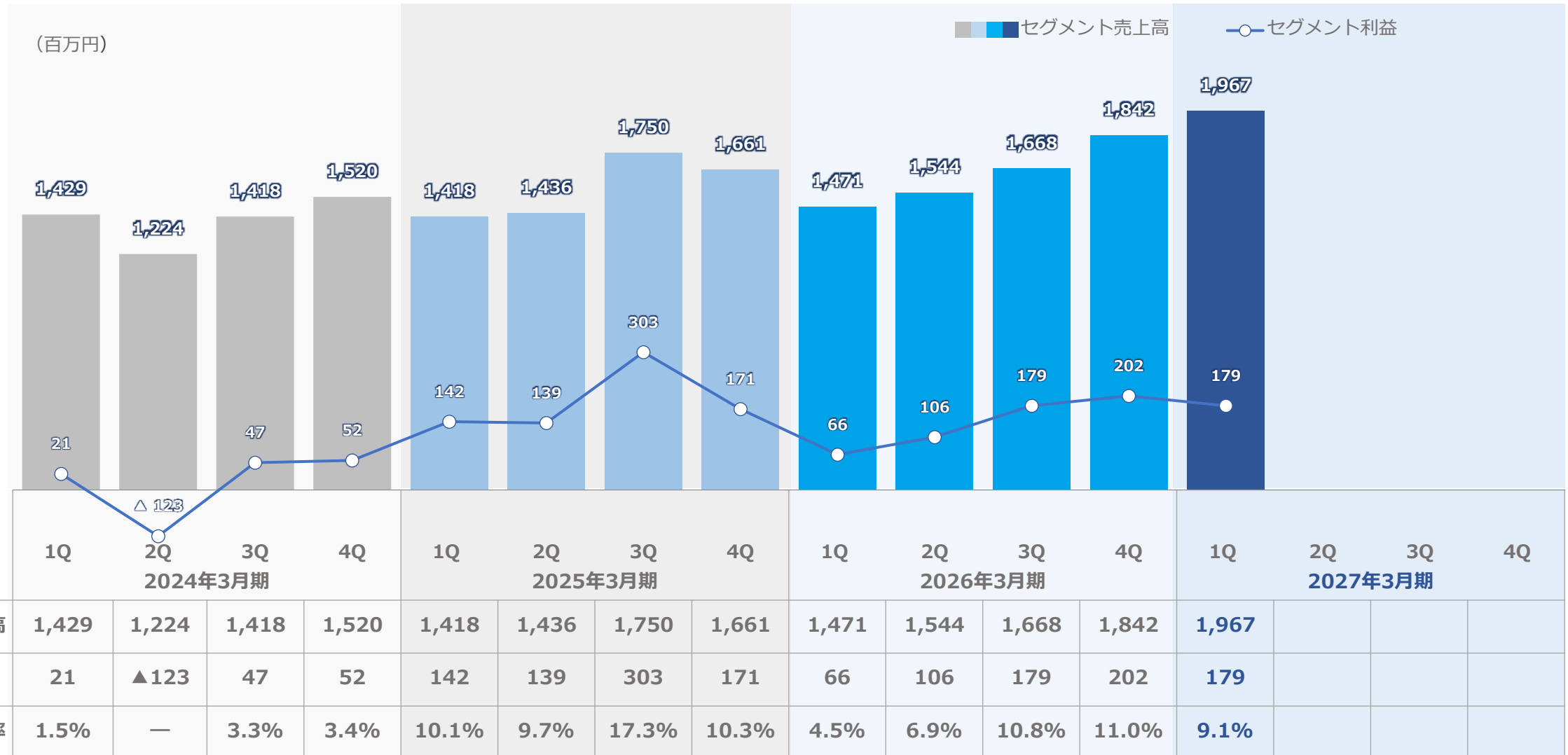
- ・ 半導体市場の活況を背景に顧客の在庫調整が一巡し、急速な受注増加により大幅な増収
- ・ 売上増加により利益額も堅調に推移



(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

# セグメント別概況 受託製造事業

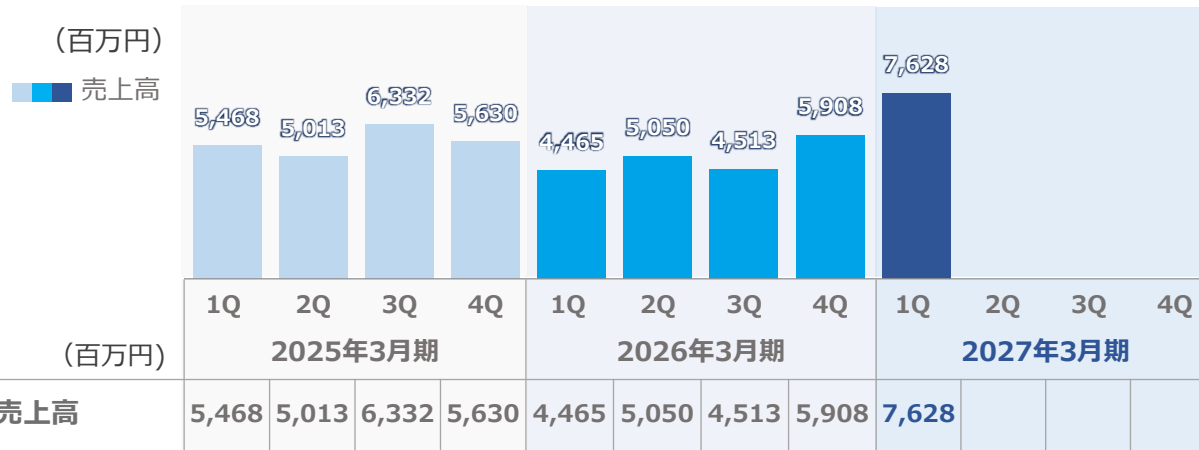
- ・ 前期から引き続き主要顧客からの受注が堅調に推移し増収
- ・ 今後の増産に向けたキャパシティ確保の先行投資により、前4Qに比べ減益



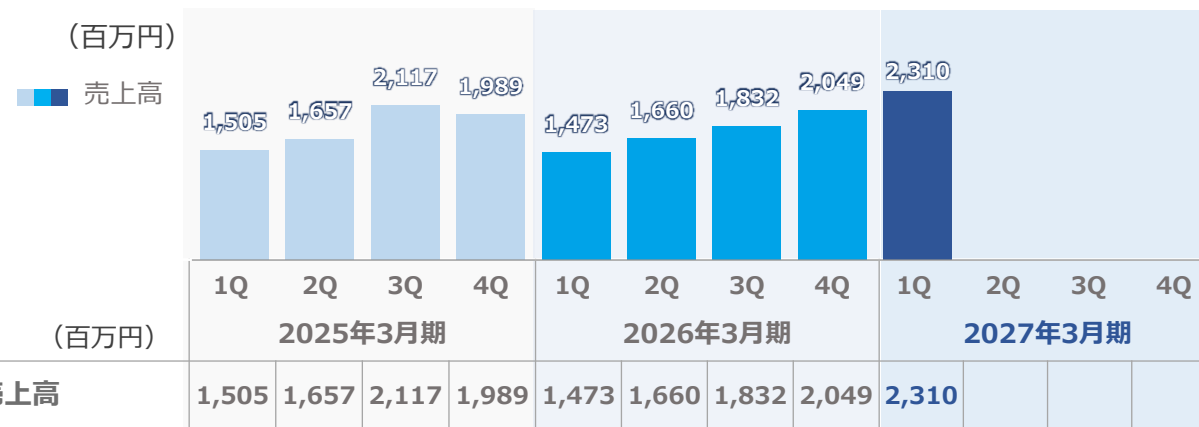
(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

# 事業ポートフォリオ別売上高の推移

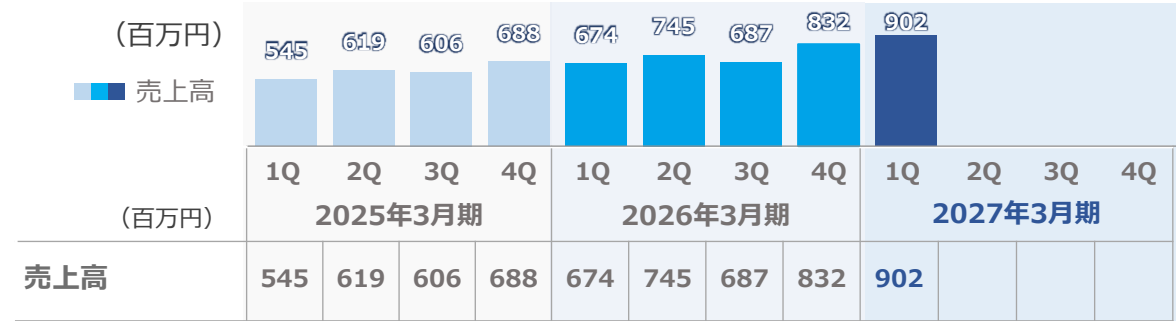
## サプライチェーン・ソリューション事業



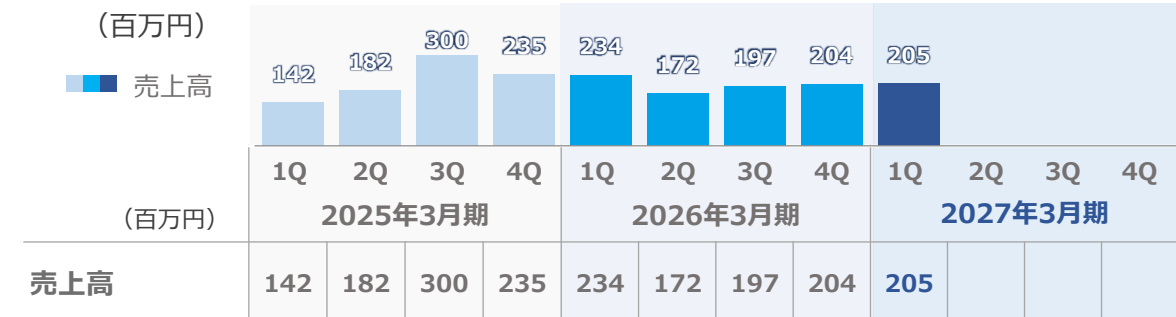
## マニュファクチャリング・ソリューション事業



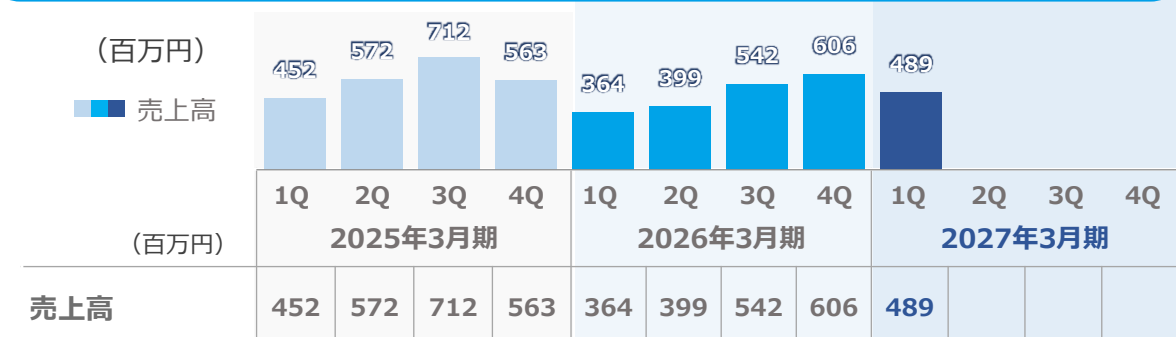
## フィールド・ソリューション事業



## テクニカル・ソリューション事業



## プレジジョンマシニング・ソリューション事業

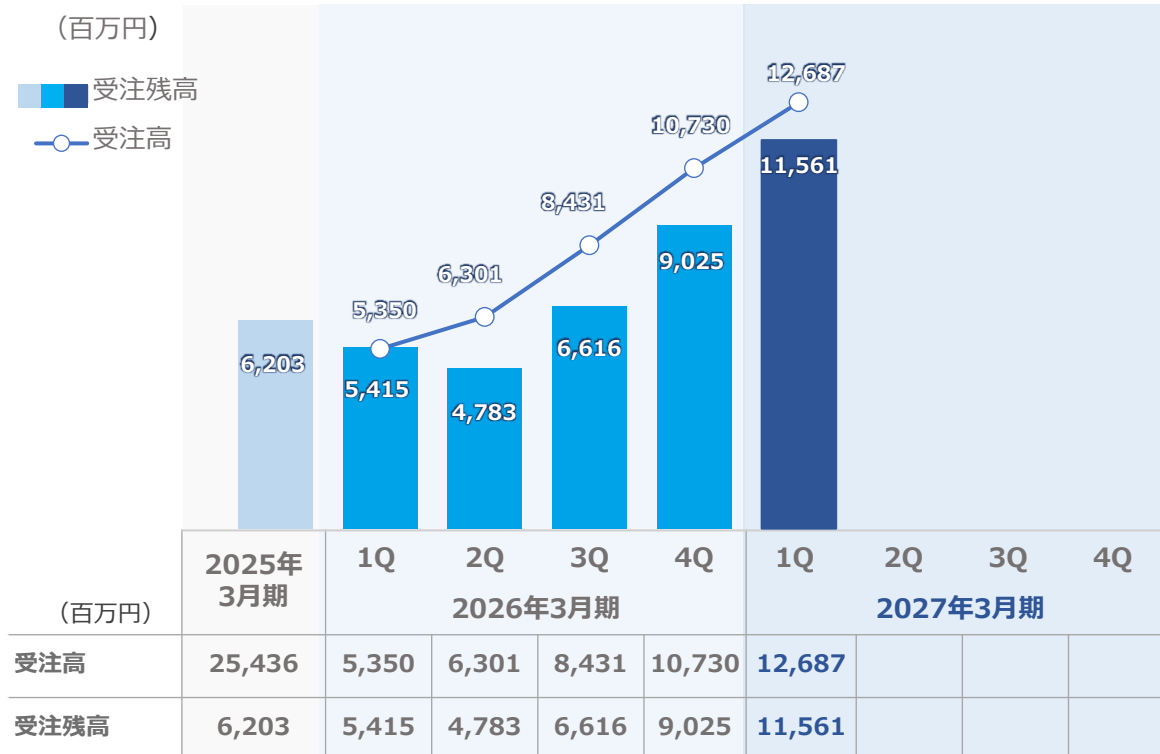


## 受注高・受注残高の推移

- ・ 販売事業・受託製造事業ともに受注高は増加傾向で推移し、受注残高はいずれも高水準に
- ・ 受注残高の積み上がりにより、今後の売上拡大の基盤を形成

### 販売事業

受注残高 **11,561**百万円  
(前期末比+28.1%)



### 受託製造事業

受注残高 **387**百万円  
(前期末比+40.4%)



## 連結貸借対照表

- ・ 売上増加により、資産における現預金及び売上債権、負債における買入債務が増加
- ・ 棚卸資産は、堅調な受注を背景に増加
- ・ 自己資本比率は、売上拡大に伴う買入債務の増加により、前期末の50.9%から46.5%に低下

### 連結貸借対照表

■ 現金・預金  
 ■ 売上債権  
 ■ 棚卸資産  
 ■ その他流動資産  
 ■ 有形固定資産  
 ■ その他固定資産  
 ■ 買入債務  
 ■ 有利子負債  
 ■ その他負債  
 ■ 純資産

(百万円)

|        | 2026年3月期 1Q | 2026年3月期 2Q | 2026年3月期 3Q | 2026年3月期 4Q | 2027年3月期 Q1 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (百万円)  |             |             |             |             |             |
| 純資産    | 11,696      | 11,945      | 12,252      | 12,761      | 13,165      |
| 自己資本比率 | 48.7%       | 50.2%       | 51.2%       | 50.9%       | 46.5%       |

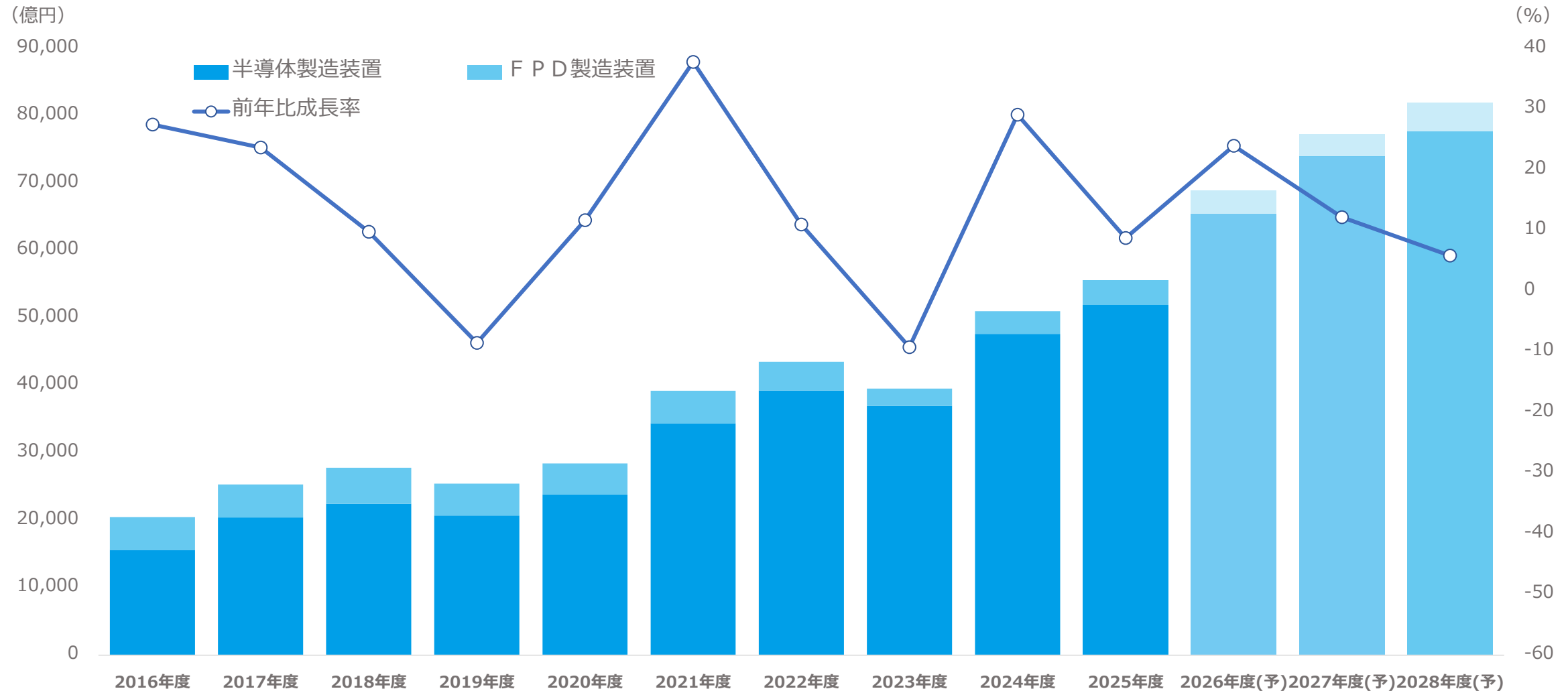


# 2027年3月期 連結業績予想

# 半導体製造装置市場動向

- ・ A I 関連半導体の需要が牽引し、中長期的に力強い成長が継続する見通し

## 半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



出所：SEAJ 2026年7月2日発表資料を基に当社にて作成

## 2027年3月期 通期連結業績予想（上方修正）

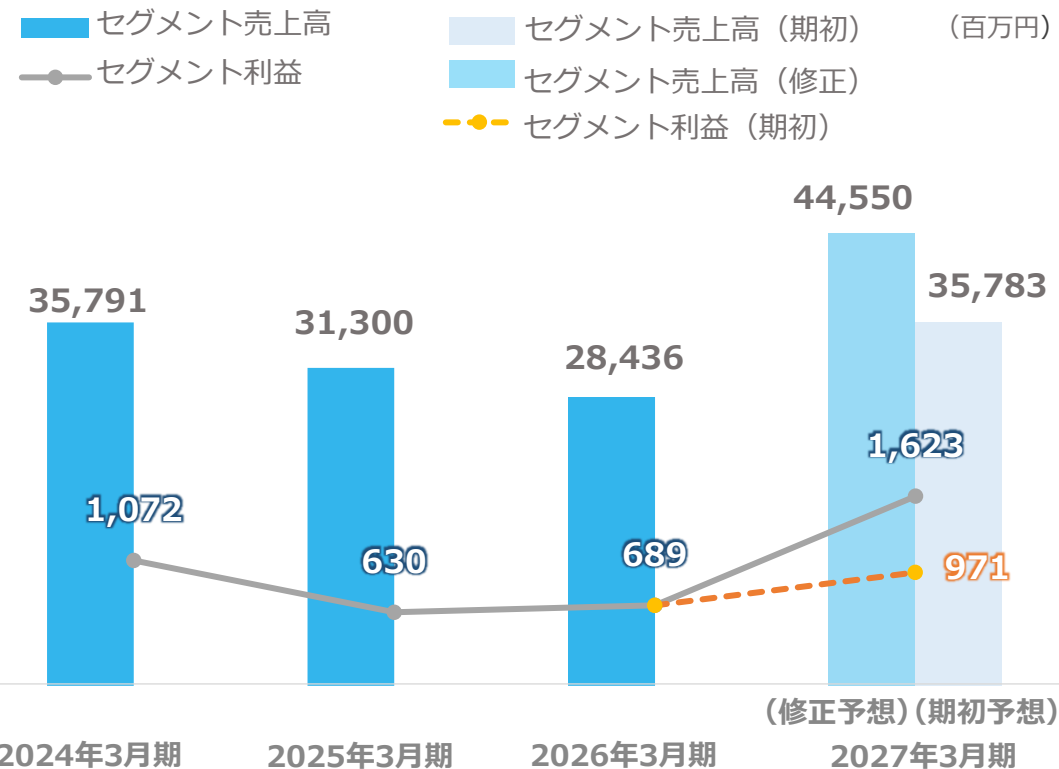
- ・ A I 関連を中心とした著しい需要拡大を背景に、大幅な増収を見込む
- ・ 原材料価格や人件費の上昇等のコスト面での上昇圧力のほか、今後の増産に向けた先行投資や中期経営計画「MIRAI 2030」に基づく成長投資から費用増加はあるも、増収効果が上回り増益見通し

| (百万円)               | 2026年3月期 |       |       | 2027年3月期 |       |       |        |       |                   |        |
|---------------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------------------|--------|
|                     | 通期       |       |       | 通期       |       |       | 第2Q累計  |       | 期初予想<br>(5月15日開示) |        |
|                     | 実績       | 前期比   | 構成比   | 通期予想     | 前期比   | 構成比   | 中間予想   | 前年同期比 | 通期                | 中間     |
| 売上高                 | 32,614   | ▲7.7% | 100.0 | 50,900   | 56.1% | 100.0 | 24,500 | 60.8% | 40,600            | 19,000 |
| 営業利益                | 1,402    | ▲9.6% | 4.3   | 2,560    | 82.5% | 5.0   | 1,185  | 2.4倍  | 1,500             | 552    |
| 経常利益                | 1,389    | ▲9.0% | 4.3   | 2,540    | 82.8% | 5.0   | 1,178  | 2.5倍  | 1,460             | 530    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 971      | ▲7.4% | 3.0   | 1,680    | 72.9% | 3.3   | 747    | 2.4倍  | 1,000             | 347    |
| 1株当たり配当金            | 105.0円   | —     | —     | 144.0円   | —     | —     | —      | —     | 110.0円            | —      |

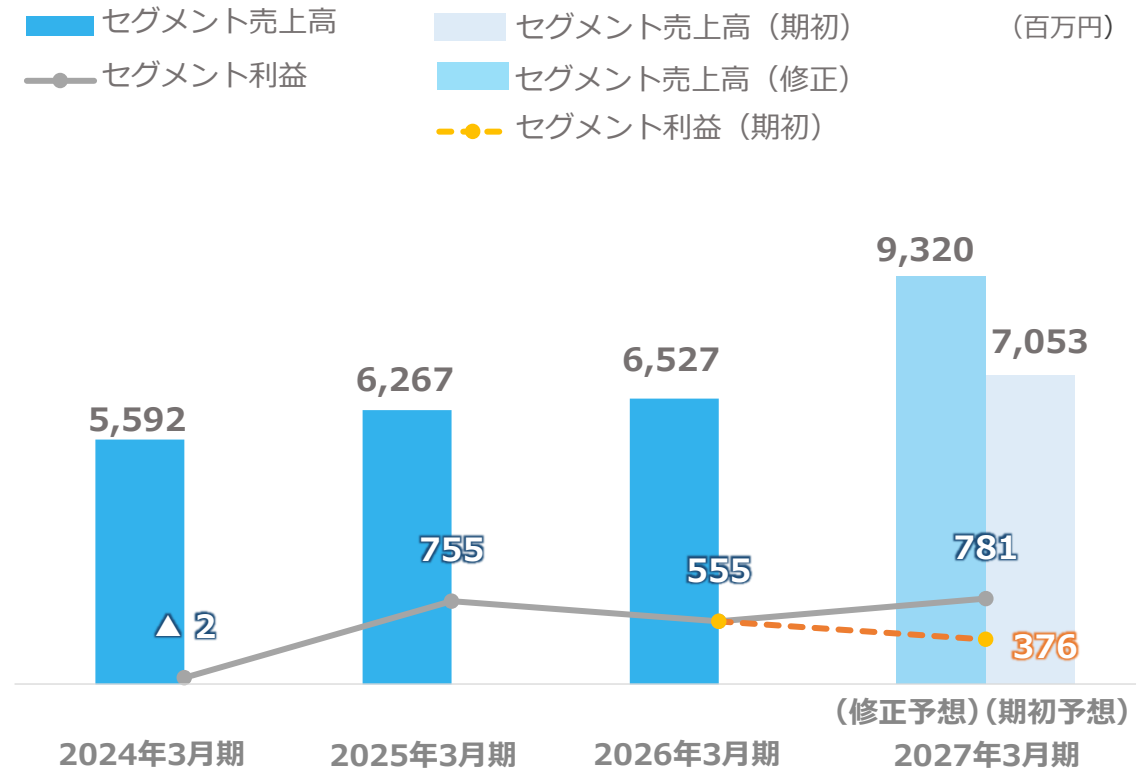
# セグメント別業績予想

- ・半導体市場の活況を背景に、販売事業・受託製造事業ともに上方修正
- ・販売事業は、堅調な受注を背景に大幅な増収増益を見込む
- ・受託製造事業は、増収を見込むも、キャパシティ確保の先行投資により利益増加幅は限定的

## 販売事業



## 受託製造事業



(注) セグメント売上高及びセグメント利益は、連結調整前の数値となっております

## 配当政策

- ・ 今後の成長のための投資と株主様への還元のバランスを考慮しつつ、企業価値向上を目指す
- ・ 業績好調を背景に、期初予想110円から144円へ大幅な増配を見込む

### 基本方針

連結配当性向 **30%以上**

連結株主資本配当率  
(DOE) **3%以上**

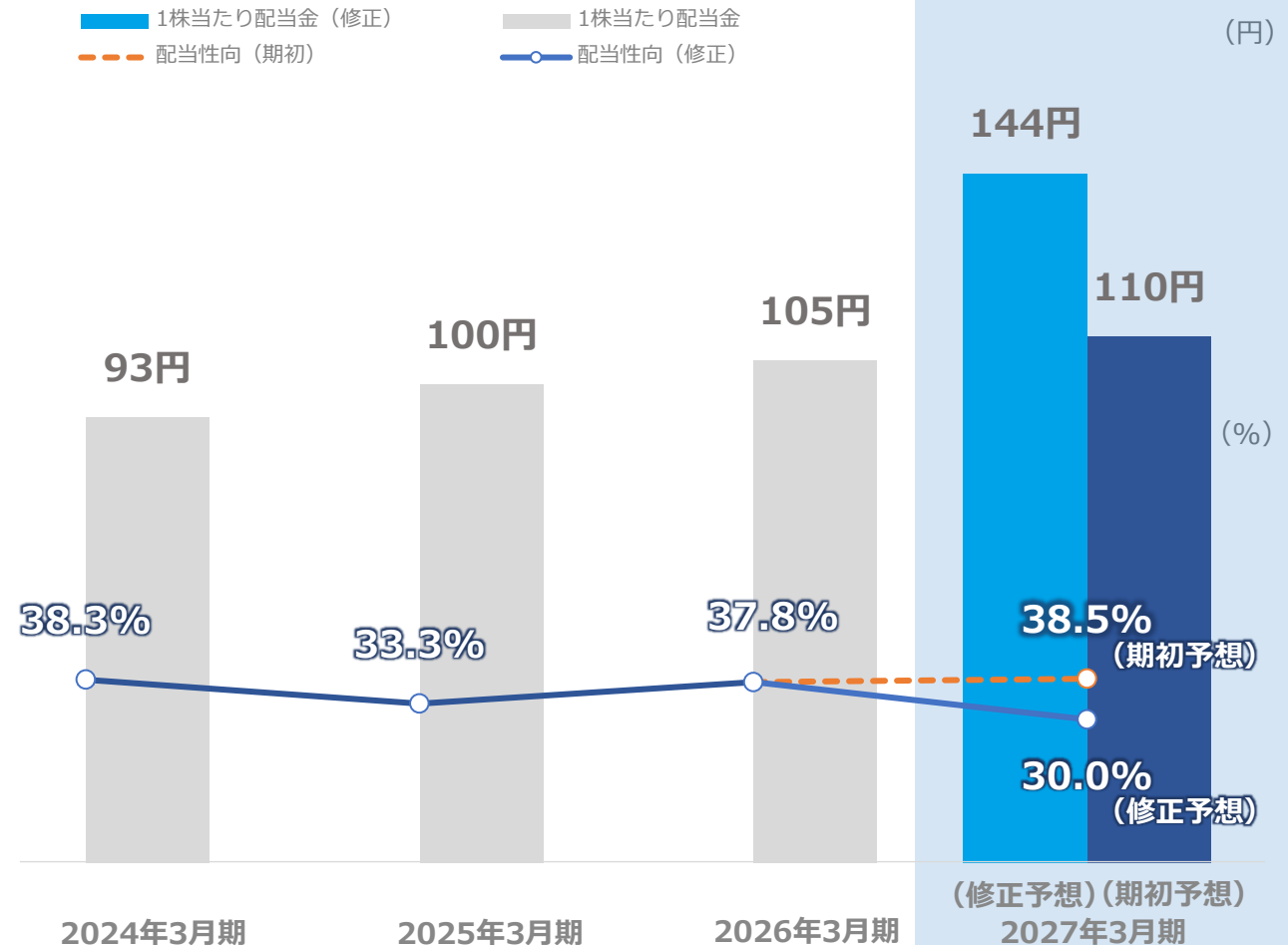


業績に応じた配当を継続していく

\* 2024年2月13日配当方針の変更

### 株主還元に係る当社の考え方

- ・ 中長期的な視点を持って継続的な企業価値向上により株主様へ還元してまいります
- ・ 今後のさらなる半導体市場の成長を確実にキャッチアップするため、新しい事業領域を含めたM & Aをはじめ、工場の新設等、今後も積極的に投資を行っていきたいと考えております





中期経営計画

**MIRAI 2030進捗**

# MIRAI 2030進捗 基本戦略（MIRAI 2026 継続）

## 1. 生産キャパシティ・物流キャパシティ拡大

### 5月7日 宮城物流センター（大衡及び利府）移転

- ・ 2027年度以降のAI投資増に対応するも、受注前倒しにより、タイムリーに効果を発揮
- ・ 物流キャパシティは1.5倍に拡大

### 6月1日 仙台第二工場新設

- ・ 現在仙台事業所で生産している半導体製造装置の保守・改造品のアッセンブリ品増産に対応
- ・ 生産キャパシティは2倍に拡大

## 2. 技術開発強化

- ・ 仙台開発センターの研究棟として開設
- ・ 熟技術に対応する開発力を強化
- ・ 現在、電源工事中
- ・ 2026年11月操業開始予定



仙台開発センター（キュービクル設置）



仙台第二工場・宮城物流センター（1F、4Fを賃借）

# MIRAI 2030進捗 基本戦略（MIRAI 2026 継続）

## 3. メンテナンス拡大

8月1日 株式会社OMTの株式を取得し、連結子会社化

### <株式取得の背景>

#### ■ 外部環境の追い風

- ・ 日本政府の国内半導体産業への支援強化 ⇒ 10兆円以上の公的支援実施
- ・ 経済安全保障を背景に、半導体の国内製造回帰
- ・ 2026年度以降の設備保全需要は年15～20%で成長見込み

### <協業の目的>

#### ■ 半導体製造設備の保守・メンテナンス事業の拡大

- ・ 両社の強みを活かして、業界でのポジションを最大化



## 参考資料

# 参考資料 会社概要

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 本社所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋                                   |
| 設立    | 1961年6月                                       |
| 事業内容  | 半導体製造装置の部品の仕入販売、<br>受託製造が2本柱                  |
| 従業員数  | 連結 687名（2026年3月末）                             |
| 連結子会社 | 内外エレクトロニクス株式会社<br>株式会社OMT<br>納宜伽義機材（上海）商貿有限公司 |



本社・東京営業所

納宜伽義機材（上海）  
商貿有限公司

仙台事業所

国内 **36** 拠点

海外 **2** 拠点

❖ 内外テック **20** 拠点  
 ❖ 内外エレクトロニクス **15** 拠点  
 ❖ OMT **1** 拠点  
 ❖ 内外機材(上海) **2** 拠点



# 参考資料 当社グループの主力ビジネス

## 半導体製造工程概要



内外テック  
技術提案商社



内外エレクトロニクス  
受託製造メーカー



OMT  
半導体製造設備  
メンテナンス



## モノづくりができるメーカー商社

# 参考資料 事業ポートフォリオ概要

## ・資本の最適配分を目指し、事業ポートフォリオ管理を実施

### 事業ポートフォリオの概要

#### 事業ポートフォリオ

##### SS事業

##### MS事業

##### FS事業

##### TS事業

##### PS事業

#### 事業ポートフォリオ 事業概要

##### サプライチェーン・ソリューション事業（販売）

- ・豊富なラインナップと幅広いサプライチェーンにおける市場ニーズ対応

##### マニファクチャリング・ソリューション事業（受託組立）

- ・カスタマイズされた製品の組立て
- ・高度な技術力とスピードで顧客の特定ニーズに対応

##### フィールド・ソリューション事業（メンテナンスサポート）

- ・製品の長期的な性能維持をサポート
- ・実績と経験に基づく信頼性の高いサービスの提供

##### テクニカル・ソリューション事業（製品開発・技術開発）

- ・革新的な自社製品の開発
- ・設計段階から顧客ニーズに沿った最適な技術を提供

##### プレジジョンマシニング・ソリューション事業（精密加工）

- ・精密部品の製造と加工
- ・高精密な加工技術と品質管理

# NaigaiTEC Corporation

- ・本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません
- ・本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません
- ・銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします

## 内外テック株式会社

<https://www.naigaitec.co.jp>

スタンダード：3374